**附件1**

**半导体产业前沿技术的发展与应用高级研修班**

**课程安排表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **时 间** | | **内 容** | **主 讲 人** |
| 6月19日 | | 报 到 | |
| 6月20日 | 上 午 | 开班仪式 | |
| 功率半导体的市场与技术发展 | 张波 |
| 下 午 | 三维封装技术 | 林媛 |
| 6月21日 | 上 午 | 数字化微波 | 罗讯 |
| 下 午 | 电源管理芯片的挑战与技术趋势 | 罗萍 |
| 6月22日 | 上 午 | SOC技术及其发展 | 王忆文 |
| 下 午 | 第三代半导体技术展望 | 王超 |
| 6月23日 | 上 午 | 微系统技术 | 李威 |
| 下 午 | 硅基射频CMOS/LDMOS技术发展及特点 | 谭开洲 |
| 6月24日 | 上 午 | 现场教学 | |
| 下 午 | 分组讨论、测评、学员总结 | |